

## 产品指标

### 1550 nm 宽带 SLED

#### ➤ 特性

- 出纤功率 >8mW
- 典型3dB带宽60nm
- 典型光谱调制0.2dB
- DIL和BTF两种封装
- 单模光纤

#### ➤ 应用

- 光纤陀螺
- 光学测试设备
- 光纤传感
- 光纤通讯
- 光学相干影像
- 生物医疗影像设备
- 临床治疗设备

#### ➤ 绝对最大值

参数	符号	条件	最小	最大	单位
反向电压	$V_R$			2	V
前向电流	$I_F$			350	mA
前向电压	$V_F$	$I_{op}$		2.5	V
箱体温度	$T_c$	$I_{op}$	-40	65	°C
SLED温度	$T_{SLED}$	$I_{op}$	0	70	°C
TEC电压	$V_{TEC}$			3	V
TEC电流	$I_{TEC}$			1.8	A
储存温度	$T_{stg}$	无偏袒的	-40	85	°C
储存湿度			5	85	%RH
静电放电 (ESD)	$V_{ESD}$	人体模式		500	V
引脚焊接温度	$S_{temp}$			260	°C
引脚焊接时间	$S_{time}$			10	sec

#### ➤ 指标参数 (TSLED = 25 °C)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
工作电流	$I_{op}$				300	mA
前向电压	$V_F$	$I_{op}$			2	V
单模光纤中的功率	$P_o$	$I_{op}$	8			mW
中心波长	$\lambda$	$I_{op}$	1530	1550	1570	nm
带宽	$B_{FWHM}$	$I_{op}$	55	60		nm
光谱调制	R	$I_{op}$		0.2	0.4	dB
热敏电阻	$R_{therm}$	T = 25 °C	9.5	10	10.5	kΩ

## 产品指标

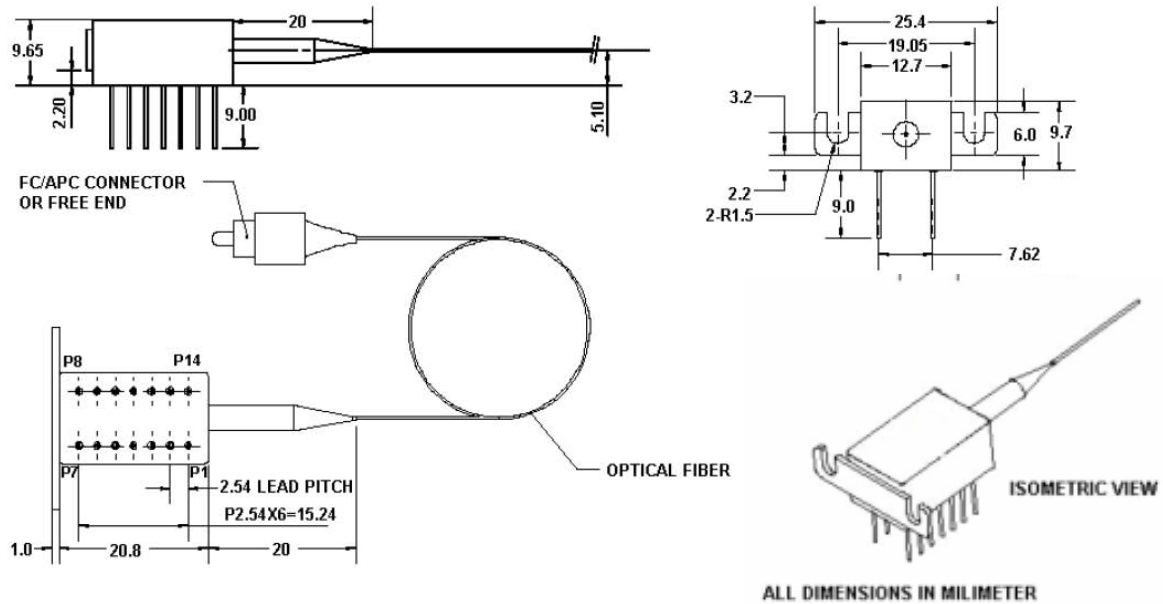
TEC电压	$V_{TEC}$	$I_{op}$		2.5	V
TEC电流	$I_{TEC}$	$I_{op}$		1.1	A

(1)  $T_{SLED}$  是内部热敏电阻监视得到并由外部引脚输出的。

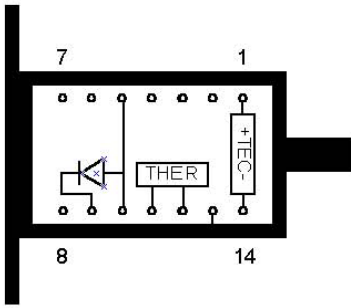
### 封装

部件	描述
封装类型	DIL
光纤	SMF-28
MFD	10 $\mu$ m
包层直径	125 $\mu$ m
涂覆层直径	245 $\mu$ m
保护套	900 $\mu$ m松套管
未纤长度	1m
光纤盘曲直径	>40mm
接头	FC/APC
尺寸	见图

### DIL型封装尺寸



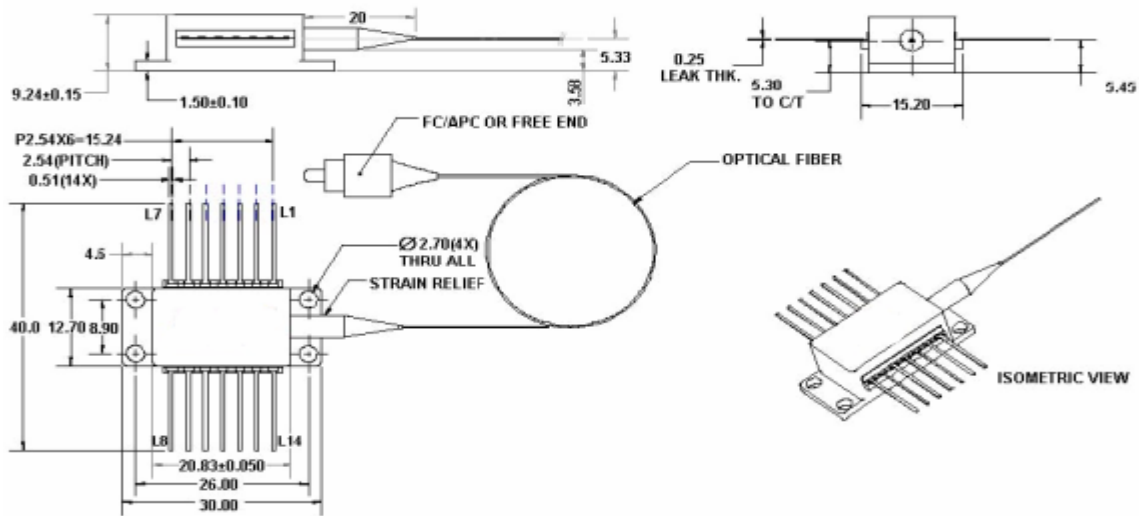
## 产品指标



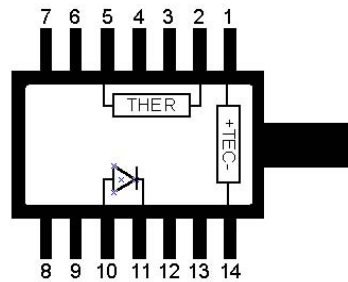
1	TEC+	8	无
2	无	9	SLED 阴极-
3	无	10	SLED 阳极+
4	无	11	热敏电阻
5	SLED+	12	热敏电阻
6	无	13	外壳
7	无	14	TEC-

管脚定义

## 蝶型封装尺寸



Pin Assignment	
1	TEC+
2	THERMISTOR
3	-
4	-
5	THERMISTOR
6	-
7	-
8	-
9	-
10	SLED ANODE +
11	SLED CATHODE -
12	-
13	CASE
14	TEC -



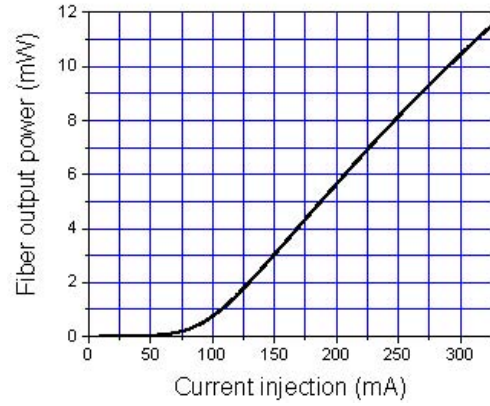
# 产品指标

## 典型性能特征

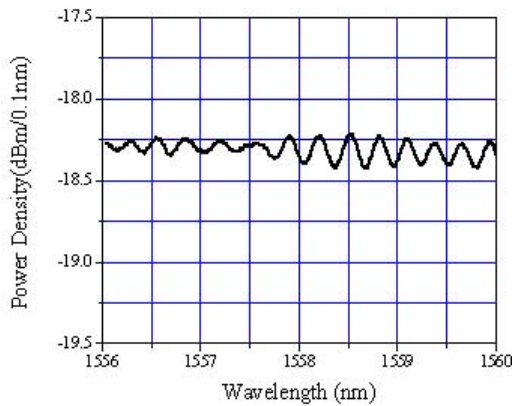
工作条件:  $T_{\text{SLED}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



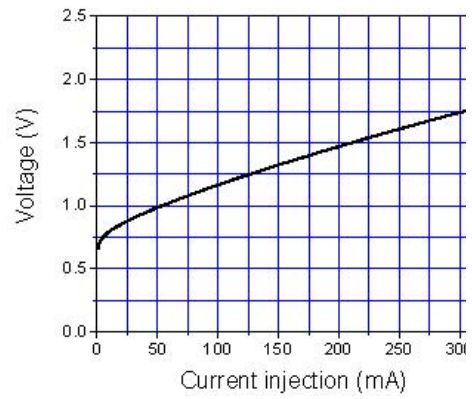
发射光谱曲线



P-I 曲线



光谱调制



I-V 曲线